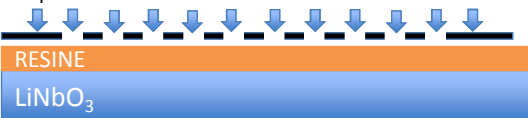


PROCEDE DE REALISATION :



1. Nettoyage et Dépôt de résine

Exposition UV



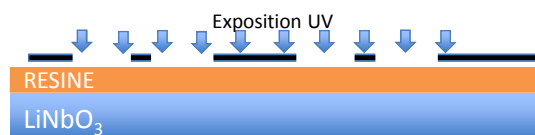
2. Face avant : Lithographie IDT



3. Révélation et Métallisation Ti/Au des IDTs



4. Lift-off



5. Face arrière : Lithographie plan de masse



6. Métallisation Ti/Au et lift-off



7. Face avant : Collage wafer verre avec colle epoxy (a) et connexion face avant/arrière par laque d'argent (b)